



Digi International kündigt die sofortige Verfügbarkeit des ConnectCore für i.MX6UL Entwicklungs-Kit an

Ein kompletter Pico-ITX Single-Board-Computer für die Entwicklung industrietauglich sicherer, intelligent verbundener Geräte und Anwendungen auf der Basis des kleinsten drahtlosen i.MX6UL System-on-Modul Plattform des Marktes

MINNETONKA, Minn., 13. Dez. 2016 - Digi International® (NASDAQ: DGII, www.digi.com), ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Machine-to-Machine (M2M) und IoT-Connectivity, kündigte heute die sofortige Verfügbarkeit des [ConnectCore für i.MX6UL Entwicklungs-Kits](#) an.



Das Kit ist ein vollständiger, unmittelbar verwendbarer Single-Board-Computer (SBC), der speziell für die schnelle Entwicklung, Prototypenanfertigung und Produktisierung einer sicheren Gateway-Plattform für intelligente, verbundene Geräte ausgelegt ist. Es ermöglicht eine effizientere und schnellere Bereitstellung von verbundenen Produkten und Anwendungen, die mehrere Access Points erfordern, und bietet höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität bei gleichzeitiger Erleichterung der Entwicklung von Schlüsselbereichen - einschließlich Display-Funktionen -, die für die Bereitstellung modernster IoT- und M2M-Lösungen unerlässlich sind.

Das ConnectCore for i.MX6UL Entwicklungs-Kit nutzt das NXP i.MX6UL System-on-Module

(SOM), um eine umfassende Softwareplattform zur Verfügung zu stellen, die wenig bis gar keine Hardwareentwicklung benötigt, um eine Vielzahl von angeschlossenen Geräten zu erstellen.

- **Eine komplette IoT-Design-Plattform:** Das Kit beinhaltet alle Funktionen auf einer Platine und ermöglicht es Entwicklern, alle Entwicklungsbedürfnisse zu berücksichtigen, darunter ein bewährtes Referenzdesign für die modulbasierte Entwicklung, eine Rapid-Prototyping-Plattform zur schnellen Erstellung eines Proof-of-Concepts und eine Plattform, die für die Produktisierung geeignet ist, um schnell vollständig entwickelte, intelligente verbundene Produkte auf den Markt zu bringen.
- **Gebrauchsfertiger Single Board Computer:** Auf der Basis des ConnectCore für i.MX6UL Moduls, bietet der SBC einen kompletten off-the-shelf SBC mit all den Eigenschaften und Fähigkeiten, um industrietaugliche kabel- und drahtlos verbundene Geräte zu bauen. Zu den Merkmalen gehören:
 - Ein kompakter Pico-ITX Formfaktor (100 mm x 72 mm) mit Montageoptionen, industrieller Betriebstemperaturbereich, 256 MB hochzuverlässiger NAND-Flash und 256 MB DDR3-Speicher - beide auf 2GB erweiterbar
 - Kabelverbundene und drahtlose Konnektivität durch ein 10/100 Mbit Ethernet-Netzwerk, vorzertifiziertes 802.11a/b/g/n/ac-WiFi-Netzwerk und Bluetooth 4.2 mit Bluetooth Low Energy (LE) -Konnektivität mit externen Antennenoptionen und Nahfeldkommunikation (NFC)
 - Optionale Mobilfunk-Anbindung über eine PCI Express-Minicard und einen integrierten Micro-SIM-Slot
 - Digi XBee-Buchse, die die breite Palette von Digi XBee RF-Modulen für 802.15.4, ZigBee, Thread, Digi Mesh™ und Sub-GHz Wireless-Konnektivität unterstützt
 - 24-Bit LVDS und RGB, parallele LCD-Unterstützung (bis zu WXGA), Kamera, SD-Kartenspeicher, integrierte eMMC-Flash-Option, energiesparende NFC-Tag-Funktionen (NXP NTAG), USB-Host/Gerät, I/O-Anschlüsse (CAN, UART, SPI, I2C, GPIO), Benutzer-LEDs und -Tasten, Stromein- / ausgang und Batterieanschluss
 - Industrieller Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C und IEC 60068-2 Konformität bei Temperatur-, Schock- und Vibrationsfestigkeit
- **Eine intelligente und sichere Communication-Engine:** Auf der Grundlage des neuen NXP i.MX 6UltraLite Applikationsprozessors ist [ConnectCore für i.MX6UL](#) SOM als intelligente Embedded Plattform ausgestaltet, die extrem wenig Platz benötigt und einen äußerst geringen Stromverbrauch hat, und damit für den Bau überaus kostengünstiger und verlässlicher verbundener Geräte ohne traditionelle Hardware- oder Software-Designrisiken bereit steht. Das Modul bietet ein einzigartiges

Low-Profile, den zum Patent angemeldeten oberflächenmontierbaren DigiSMTplus™ Formfaktor, der geringfügig größer ist als eine Briefmarke und zwei kostenoptimierte Integrationsmöglichkeiten vorsieht (LGA Komplettsystem und vereinfachte Durchkontaktierungen mit metallisierten Kanten) sowie Ultra-low Powermodi, die das Potential des nahtlos integrierten Microcontroller Assist (MCA) nutzen.



Mit dem kompletten Linux Board Support Package (BSP) von Digi, enthält das Entwicklungs-Kit eine integrierte und geprüfte Yocto-Projekt Linux-Softwareplattform, die laufend gepflegt wird und auf aktuellen Stable-Releases und Zugang zum gesamten Quell-Code basiert. Darüber hinaus stellt das neue [Digi TrustFence™ Device Security](#)

[Framework](#) wichtige und sofort verwendbare Funktionen bereit, die für die Gerätesicherheit relevant sind. Dazu gehören z. B. sichere Verbindungen, ein authentizierter Systemstart, verschlüsselte Datenspeicherung, Ports mit kontrolliertem Zugriff, sichere Software-Updates und nahtlose Integration des dezidierten On-Module-Secure-Elementes (SE).

„Das ConnectCore für i.MX6UL Entwicklungs-Kit bietet ein vollständiges und einzigartiges Referenzdesign und eine eingebettete Entwicklungsplattform für intelligente, sichere verbundene Geräte und Gateways“, so Mike Rohrmoser, Leiter Produktmanagement Embedded Systems bei Digi International. „Auf der Grundlage des standardisierten Pico-ITX-Formfaktors bietet es eine Plattform sowohl für die schnelle Entwicklung als auch für die unmittelbare Produktisierung. Es ist hoch integriert, vollständig validiert und wird von Digis Know-how, Hardware, Software und Betreuungsleistungen unterstützt.“

Im Vergleich zum Starter-Kit (siehe „[Digi International kündigt die sofortige Verfügbarkeit des ConnectCore für i.MX6UL Starter-Kit an](#)“), konzentriert sich das SBC auf die Schaffung von verbundenen Smart-Gateway-Fähigkeiten einschließlich solcher, die flexiblere Umsetzungsoptionen, wie zum Beispiel die Integration mehrerer drahtloser Technologien oder eines LCD- und Kamerasupports erfordern.

Das Digi ConnectCore 6UL Entwicklungs-Kit* ist für 249 USD erhältlich. Die Kits werden bei

autorisierten Digi-Vertriebshändlern erhältlich sein.

Digi bietet seinen Kunden zusätzliche „Go-to-Market“-Optionen an. Das Wireless Design Services Team von Digi überprüft Designs, leistet Hilfestellung bei Auswahl und Entwicklung von Antennen und bietet Unterstützung bei der Mobilfunkintegration und Zertifizierung ebenso an, wie maßgeschneiderte Sonderanfertigungen.

Unter www.digi.com/cc6ul können Bestellungen aufgegeben oder weitere Informationen abgerufen werden oder sehen Sie sich unser Video unter www.digi.com/videos/cc6ul an.

**Starter- und SBC-Boards sind serienreif und stehen separat zum Kauf zur Verfügung. Beide Kits sind zudem Referenzdesigns für das SMTplus LGA von Digi sowie die Integration des Moduldesigns mit vereinfachten Durchkontaktierungen mit metallisierten Kanten und der Verfügbarkeit der vollständigen Design-Quelldatei. Eingeschränkte Verfügbarkeit der ConnectCore 6UL Modul-Samples, der Start der Serienproduktion ist für das erste Quartal 2017 geplant, mit einem Volumenpreis von lediglich 33,00 USD.*

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist Ihr Experte für auftragsentscheidende M2M-Lösungen und bietet eines der branchenweit breitesten Angebote von drahtlosen Produkten, eine auf die Geräte abgestimmte Cloud-Computing-Plattform sowie Entwicklungsservices, mit denen die Kunden ihre drahtlosen Geräte und Anwendungen schneller auf den Markt bringen können. Das gesamte Angebot von Lösungen von Digi ist so abgestimmt, dass jedes Gerät überall auf der Welt mit jeder Anwendung kommunizieren kann. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von Digi unter www.digi.com oder telefonisch unter 877-912-3444 (USA) bzw. 952-912-3444 (international).

Pressekontakt:

Europa

Vibeke Ulmann

Catalyst Communications

Geschäftsstelle: +44 (0)1323 760 335

vibeke.ulmann@catalystpr.com